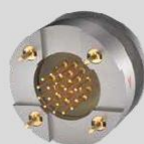
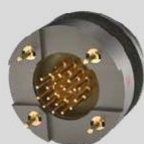
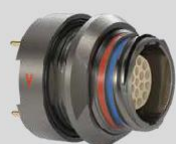


M SERIES VACUUMTIGHT



Vacuumtight

-55° to
+150°C

PCB
optimized



広い温度範囲に対応した 新型“HY”真空気密モデル

Mシリーズに新たな真空気密モデル“HY”が追加されます。
全てのシェルサイズの低電圧用レイアウトでご利用頂けます。
(低電圧以外のレイアウトは対象外)

新しい固定式ソケットモデルは、過酷な環境下で真空気密型の接続を必要とする全てのアプリケーションに向けて特別に設計されています。

新採用のポッティング材で、広い温度範囲において超低リーク率の真空封止を可能にしました。PCBテールも改良され、基板への高密度実装を容易にすることが出来ました。

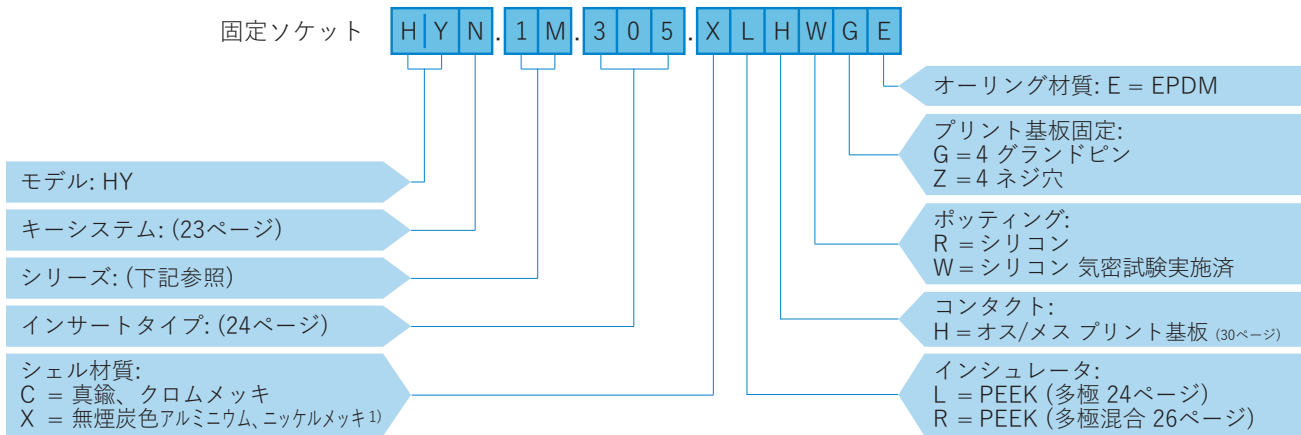
また、コネクタの基板固定方法は“標準的なグランドピン”、または“特殊な防振ねじ穴付き”を選べるようになりました。

新型“HY”真空気密モデルは、真空気密性が求められる市場で、最も気密度の高いラチェットカップリング付きコネクタを提供します。

Product safety notice & disclaimers:

Please read and follow all instructions specified on <https://www.lemo.com/en/about-lemo/product-safety-notice-and-disclaimers>

製品番号について



HYN.1M.305.XLHWGE = 固定ソケット、ナット留め、キー (N), 1Mシリーズ、多極5芯、無煙炭ニッケルメッキアルミ合金シェル PEEKインシュレータ、メス基板コンタクト、気密封止型、4グランドピン・EPDMオーリング

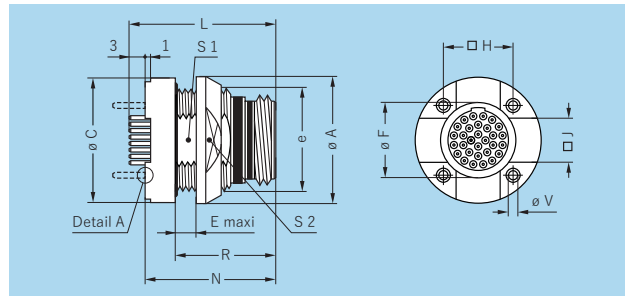
備考: ¹⁾ 無煙炭色 / 塩水噴霧48時間対応

耐環境的要素

特性	値	IEC規格
使用温度範囲(嵌合時)	-55° C/+150° C	-

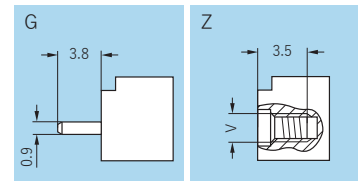
特性	値	IEC規格
漏れ率	< 10 ⁻⁷ mbar·s ⁻¹	IEC 60512-7 test 14 b

HY● 固定ソケット、ナット留め、キー (N) または (H, P, R, S, T, U, V, W, X)、基板取り付け型 気密封止型 (バックパネル取付け)



パーツナンバー		寸法(mm)												
モデル	シリーズ	A	C	e	E	F	H	J	L	N	R	S1	S2	V
HY●	MM	14.0	13.8	M10x0.50	4.0	5.7	6.35	3.0	19.1	16.1	10.5	9.0	11.0	M2x0.4
HY●	0M	17.0	16.8	M13x0.75	5.3	7.8	8.89	5.0	22.4	19.4	13.8	11.5	14.0	M2x0.4
HY●	1M	18.0	17.8	M14x1.00	5.3	8.8	10.16	5.5	22.4	19.4	13.8	12.5	16.0	M2x0.4
HY●	2M	21.0	20.8	M17x1.00	5.3	11.8	11.43	7.0	22.4	19.4	13.8	15.5	18.0	M2x0.4
HY●	3M	23.0	22.8	M19x1.00	5.3	13.8	12.70	8.0	22.4	19.4	13.8	17.5	20.0	M2x0.4
HY●	TM	27.0	25.8	M22x1.00	4.5	15.2	13.97	8.7	26.0	23.0	17.4	20.5	23.0	M3x0.5
HY●	4M	29.0	27.8	M24x1.00	4.5	16.8	15.24	9.5	26.0	23.0	17.4	22.5	25.0	M3x0.5
HY●	LM	33.0	31.8	M28x1.00	4.5	20.8	17.78	11.5	26.0	23.0	17.4	26.5	29.0	M3x0.5
HY●	5M	38.0	36.8	M33x1.00	4.5	25.9	21.59	14.0	26.0	23.0	17.4	31.5	34.0	M3x0.5

プリント基板固定 (Detail A)



グランドピン

ネジ穴

その他豊富なバリエーションは
カタログをご覧ください。

